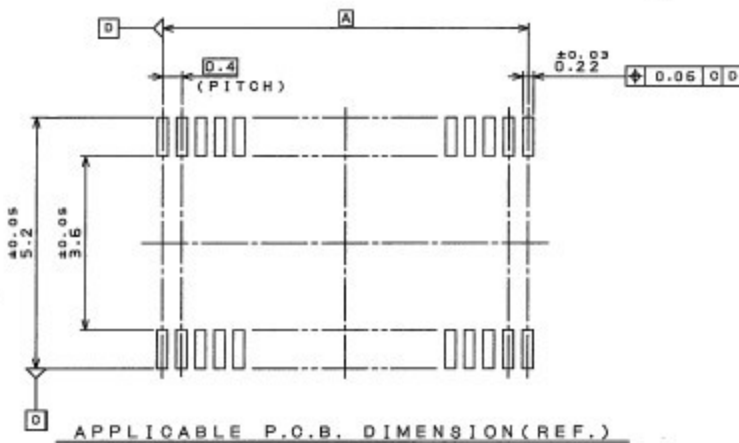
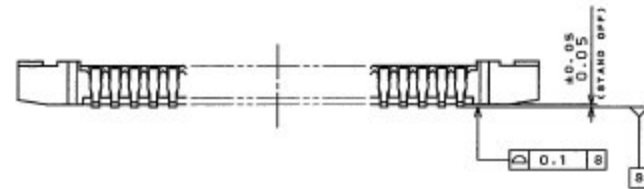
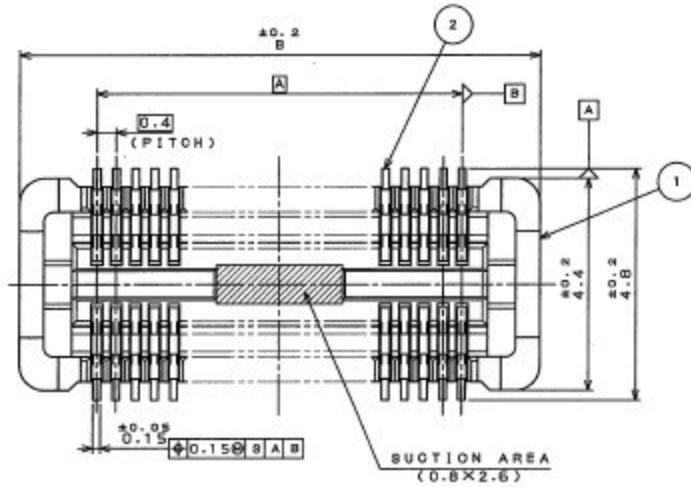


LJL2017S
(CON EN[MVPR]台巻型図)

| 版数 REV. | 年月日 DATE | 図番 DON NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 承認 APPD. | 承認 APPD. |
|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | 3.Mar.2006 | 059496 | ADDED ITEM | | H.OBIKANE | M.KIMURA | K.HISATOMI |
| 3 | 5.Feb.2009 | 067369 | ADDED ITEM | | H.MATSUZAKI | H.Obikane | Y.YAMANO |



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

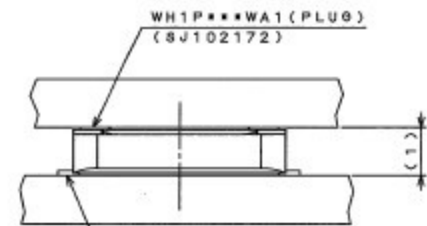
DESIGNATION
命名法

SERIES
シリーズ
CONNECTOR FORM S: RECEPTACLE
コネクタ形状 S: レセプタクル
NUMBER OF CONTACTS
芯数

WH1S***WA1
MODIFY CODE
モディファイコード
CONTACT FINISH A: GOLD PLATING (0.1μm MIN)
コンタクト仕上げ A: 金0.1μm以上
W: SMT, STRAIGHT TYPE, WITHOUT HOLD DOWN
W: SMT, ストレートタイプ, ホールドダウン無し

TABLE 1

| 名称 (TITLE) | A | B |
|--------------|-----|------|
| WH1S024WA1 | 4.4 | 7.6 |
| △ WH1S030WA1 | 5.6 | 8.8 |
| WH1S040WA1 | 7.6 | 10.8 |
| △ WH1S050WA1 | 9.6 | 12.8 |



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)

13717050755
2009.08.27
余行風

| 2 | CONTACT | N | COPPER ALLOY | GOLD PLATING (0.1μm MIN) |
|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|
| 1 | INSULATOR | 1 | GLASS FILLED LCP | |
| 符号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 個数 QTY. | 材料 MATERIAL | 仕上 FINISH |
| 仕様書 (SPECIFICATION) | JACS-10255-* | 数量 (ORIGINAL DATE) | 30.AUG.2005 | シリーズ (SERIES) |
| 一般 (GENERAL TOLERANCE) | | 製図 DR. | | 名称 (TITLE) |
| 寸法 (DIMENSION) | 角度 (ANGLES) | 担当 CHK. | R.KATO | WH1S***WA1 (RECEPTACLE) |
| . ±0.8 | X° ± | 承認 APPD. | M.KIMURA | 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. |
| .X ±0.4 | X°X' ± | 承認 APPD. | K.HISATOMI | 図面番号 (DRAWING NO.) |
| .XX ±0.1 | | | | 版数 (REV.) |
| .XXX ± | | | | 8J102171 |
| | | | | 3 |